|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID(a diligenciar por el LIEE):** | | | **Nombre:**  César Augusto Hernández Espitia | | | | | | | | | | | | | | **Código:**  200113843 |
| **Curso:**  Tesis de Doctorado | | | **Sección:** | | | **E-mail:**  ca.hernandez11@uniandes.edu.co | | | | | | | | | | | |
| **Nombre del revisor:**  Johann F. Osma | | | | | | | | | | | **E-mail:**  jf.osma43@uniandes.edu.co | | | | | | |
| X  **ENSAMBLE DE CIRCUITOS FABRICACION DE CIRCUITOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **SOLICITUD DE FABRICACIÓN DE CIRCUITOS IMPRESOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **No** | **DIMENSIONES** | | **PCBs REQUERIDOS** | **TIPO DE SUSTRATO** | | | **NUMERO DE CAPAS** | | **ESTAÑO** | | | | **THROUG HOLE** | | **ANTISOLDER** | | **NOMBRE DEL ARCHIVO ADJUNTO** |
| **ALTO cm)** | **ANCHO (cm)** | **SI** | **NO** | | | **SI** | **NO** | **SI** | **NO** |
| **1.** | 5.588 | 8.763 | 2 PCB | FR-4 | | | 1 | |  | X | | |  | X | X |  | Shield\_microscope.\* |
| **2.** |  |  |  |  | | |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |
| **OBSERVACIONES** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **SOLICITUD DE ENSAMBLE DE CIRCUITOS IMPRESOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Circuito fabricado Suministrado por el usuario Nombre del archivo adjunto\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. **COMPONENTES SUMINISTRADOS POR EL ALMACEN (DESCRIPCIÓN)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Revisado por:** | | | | | **Fecha(dd/mm/aaaa):** | | | | | | | **Aprobado Cancelado** | | | | | |
| **OBSERVACIONES** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ENTREGADO POR** | | | | | | | | **RECIBIDO POR** | | | | | | | | | |
| **Firma:**  **Nombre:** césar Augusto Hernández E.  **Fecha(dd/mm/aaaa):** 23/05/2017 | | | | | | | | **Firma:**  **Nombre:**  **Fecha(dd/mm/aaaa):** | | | | | | | | | |

***NOTA: El LIEE no se hace responsable por el estado de los componentes y el funcionamiento de los circuitos después del ensamble.***